

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-010

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股，每股发行价20.83元人民币，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币4,999,999,851.17元，扣除发行费用人民币53,814,364.71元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币4,946,185,486.46元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告予以确认。

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为人民币73,730.95万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额（万元）
再融资募集资金专户年初金额	157,339.63
加：年初用于现金管理金额	165,000.00
再融资募集资金年初金额	322,339.63
减：本年度直接投入募投项目	133,717.90
用于现金管理金额	120,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	5,109.22
再融资募集资金专户期末余额	73,730.95

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年 11 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的向特定对象发行 A 股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额（万元）
平安银行上海南京西路支行	上海硅产业集团股份有限公司	15981666888880	活期	605.75
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	03004841882	活期	6,239.66
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	457282551286	活期	106.87
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510806	活期	448.34
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶投半导体科技有限公司	121945833410718	活期	0.01
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶科半导体科技有限公司	121945865110918	活期	35,124.21
上海银行嘉定支行	上海新傲科技股份有限公司	03004911414	活期	31,206.11
<b>总计</b>				<b>73,730.95</b>

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于 2022 年 2 月，公司及保荐机构分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 5 月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 6 月，公司及保荐机构与上海新傲科技股份有限公司并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 7 月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司、上海晶昇新诚半导体科技有限公司(后更名为“上海新昇晶投半导体科技有限公司”，以下简称“新昇晶投”)、上海新昇晶科半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

## 三、2023 年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1：2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。

### （二）募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至 2022 年 5 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,941.99 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至 2022 年 5 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第 4117 号）。

2022 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立

董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 6 月 24 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司使用募集资金 14,941.99 万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 14,941.99 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

### （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2022 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第三十九次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 350,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 3 月 18 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2023 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 330,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2023 年 4 月 10 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 120,000 万元。

受托方	类型	金额(万元)	认购日	到期日	收益类型	预计年化收益率	是否到期
上海银行嘉定支行	大额存单	30,000.00	2023-10-13	2024-1-13	保本固定收益	1.800%	否
上海银行嘉定支行	大额存单	90,000.00	2023-10-17	2024-1-17	保本固定收益	1.800%	否
合计	/	120,000.00	/	/	/	/	/

#### (四) 募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，同意项目的原实施主体上海新昇半导体科技有限公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后，再由项目的现实实施主体上海新昇晶科半导体科技有限公司使用募集资金对上述款项做等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2023 年 4 月 10 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的核查意见》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、变更募投项目实施主体的情况

2022 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议，并于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，募投项目“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”原实施主体上海新昇半导体科技有限公司以募集资金 15 亿元投资并控股上海晶昇新诚半导体科技有限公司（以下简称“晶昇新诚”）（后更名为“新昇晶投”），再由晶昇新诚（后更名为“新昇晶投”）以募集资金 15 亿元出资参与设立二级控股子公司上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”），并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。

由于上述募投项目实施主体变更事项，新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。

## 六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

## 九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

## 十、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用

募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。  
保荐机构对沪硅产业 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

#### 十一、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

（二）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

附件 1：2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				4,946,185,486.46		本年度投入募集资金总额				1,337,178,989.25		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				3,119,559,766.37		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目	无	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,177,215,403.46	1,180,816,000.05	-319,183,999.95	78.72%	不适用	不适用	不适用	否
300mm 高端硅基材料研发中试项目	无	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	159,963,585.79	492,558,279.86	-1,507,441,720.14	24.63%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	1,500,000,000.00	1,446,185,486.46	1,446,185,486.46	-	1,446,185,486.46	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	5,000,000,000.00	4,946,185,486.46	4,946,185,486.46	1,337,178,989.25	3,119,559,766.37	-1,826,625,720.09	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、2023 年度募集资金实际使用情况（二）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、2023 年度募集资金实际使用情况（三）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				详见“三、2023 年度募集资金实际使用情况（四）”								



注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。